

DY 系列硅胶垫片

概述

DY 系列硅胶垫片具有一定的柔软可压缩性，表面自带粘性，可与泡棉良好贴合，能够充填缝隙，并且受挤压时由于自身的蠕变作用，产生适应性的形变，降低或消除应力，避免顶印现象的出现，达到“以柔去痕”的效果。本产品具有优良的工艺性和使用性，且厚度适用范围广，是一种极佳的柔性填充材料，广泛应用于电子电器产品中。

特点

- 蠕变适应性，变形能力强
- 自愈性强，快速无痕恢复
- 柔软兼有弹性，适合填充使用
- 硬度均匀稳定，公差小于行业范围
- 模切性能优异，不残胶不溢胶
- 表面服贴性能好
- 硅胶面自带适中粘性，粘力长期稳定
- 低分子硅氧烷挥发量极低，可避免触电故障和光学污染等现象

应用

- 公差弥补
- 蠕变缓冲
- 消除顶印

环保要求

- 该系列产品符合 RoHS，卤素管控标准

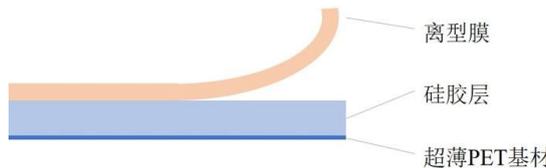
储存方式

- 储存条件：阴暗处储存；
- 储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ；
- 储存湿度： $\leq 70\%$ ；
- 堆放高度不超过 7 层，总高小于 1m

保质期：在储存条件下两年。

产品规格

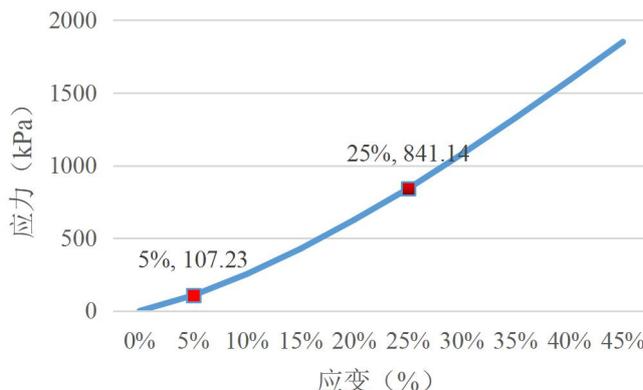
- 长宽尺寸：0.5m \times 100m，卷材形式出厂
- 产品厚度：0.15mm，可依客户要求定制



性能参数

基本性能	测试方法	典型值
颜色	目测	透明主体/黑色底膜
厚度 (mm) 公差 (%)	厚度规	0.15 ± 10
密度 (g/cm ³)	ASTM D792	0.95~1.00
25%压缩反弹应力 (kPa)	压缩速度 5mm/min	730~870
硅胶面粘力 (gf/25mm)	180 度剥离法	25~30
体积电阻率 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	ASTM D257	3.4×10^{15}
推荐使用温度 ($^{\circ}\text{C}$)	/	-40~120
低分子硅氧烷含量 (ppm)	/	<200

DY 垫片压缩曲线



该资料中所包含的真实可靠的数据信息旨在协助您采用广迈 DY 硅胶垫片材料进行设计，基于我们目前的认知和经验确定的产品应用范围，无意且不构成任何明示的或隐含的担保，包括对商品适销性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途中达到本资料中显示的结果。对于范围之外的应用，或者是不同条件和环境下的使用，产生的结果本司将不负任何责任。

联系方式：东莞市松山湖高新技术产业开发区科技十路 5 号国际金融 IT 研发中心 16 座 B 栋 Tel: 0769-26621791

<http://www.guangmai.com>